



全球半导体行业周报

政策、制程、存储、封装、设备、资本市场与管理观察

发布主体：百思特变革研究院 半导体智库

报告周期：2026-06-21 至 2026-06-27

读者定位：企业家、投资者、产业链研究专家、管理咨询专家

核验口径：企业IR、政府/监管、交易所、产业机构优先；媒体报道和研究判断按来源级别标注。

本期总判断

本周半导体主线从“AI算力景气是否延续”转为“AI基础设施能否被全栈交付”。Micron财报确认存储利润池上行，美国CHIPS资金开始补SiC功率器件与先进制造短板，TSMC技术论坛继续把先进制程、先进封装和特殊工艺打包成平台竞争；同时，出口管制、区域化建厂和A/H股半导体链交易热度，使产业竞争从单点技术扩展为资本、政策、供应链与组织能力的系统战。

一、执行摘要：六个关键变化

- Micron于2026-06-24发布2026财年第三季度业绩，收入、盈利和现金流均显示存储上行周期仍在强化。结合DRAM、HBM、企业级SSD、NOR Flash和SLC NAND价格口径，AI服务器正在通过高容量内存、HBM和企业SSD优先级重排传统终端供应。
- 美国CHIPS Program在2026-06-25宣布对i-Pulse签署2.5亿美元研发奖励，方向指向SiC功率半导体制造技术。政策资金从先进逻辑继续外溢至功率器件、汽车电动化、能源基础设施和工业电源链条，说明“供应链安全”不再只等同于先进制程。
- TSMC 2026中国技术论坛于2026-06-25举行，官方议程覆盖3nm、2nm、A16、A14、3DFabric、CoWoS、SolC、InFO和特殊工艺。台积电的竞争逻辑越来越像“系统级制造平台”，不是单一晶圆代工节点。
- 出口管制继续构成企业经营约束。BIS对Country Group D:5与澳门总部或最终母公司实体的先进计算物项许可口径，将影响中国总部企业的境外数据中心、云服务、系统集成和AI基础设施采购。
- 资本市场在本周呈现“美股AI芯片高位震荡、A/H股设备封测与存储继续修复”的分化。Yahoo Finance快照显示，本周华虹半导体H股、北方华创、中微公司、长电科技、兆易创新等代表标的涨幅突出，而部分美股和台韩日龙头回调。
- 先进封装、光互连、HBM、SiC功率器件、检测量测、关键零部件和AI in fab成为产业链瓶颈清单。对企业家和咨询顾问而言，下一阶段管理重点不是“追热点项目”，而是把研发、产能、良率、采购、合规和全球化组织放进同一套运营体系。

二、本周重大事件矩阵

日期	领域	事件	产业含义	来源
2026-06-24	美国 / 存储	Micron发布2026财年第三季度业绩，确认AI驱动的DRAM/HBM/企业级SSD需求仍强。	存储利润池从周期修复进入结构性重估；HBM认证、先进封装和高容量内存供给成为AI服务器交付关键。	S1
2026-06-25	美国 / 功率半导体	CHIPS Program宣布对i-Pulse签署2.5亿美元R&D奖励，聚焦SiC功率半导体制造技术。	SiC从新能源车链条扩展到电网、工业电源和AI数据中心能效；美国补贴范围继续从先进逻辑扩至关键材料与功率器件。	S2
2026-06-25	中国大陆 / 台积电生态	TSMC 2026中国技术论坛举行，议程覆盖3nm、2nm、A16、A14、3DFabric与特殊工艺。	头部代工厂以工艺、封装、IP和设计生态整体锁定客户，先进制程竞争转向平台化。	S3
2026-06-21至06-27	全球 / 出口管制	BIS先进计算物项D:5与澳门实体口径继续影响跨境AI基础设施采购。	企业合规从客户注册地审查升级为最终母公司、控制权、物项分类和最终用途的综合审查。	S5/S6
2026-06-21至06-27	全球 / 存储价格	TrendForce近期口径显示DRAM、NOR Flash、SLC NAND和企业SSD价格持续偏强。	AI产能优先级挤压消费电子、汽车和工业控制链条，客户BOM与库存策略需要重估。	S10/S11
2026-06-21至06-27	中国 / 资本组织	长江存储拟出让武汉新芯39%股权事件继续发酵，武汉特色存储/代工资产边界更清晰。	中国存储链的资本路径、地方国资角色和主业边界将影响后续融资与产能扩张。	S19
2026-06-21至06-27	美国 / AI ASIC与网络	NVIDIA、Broadcom等此前披露的AI平台和ASIC收入继续成为本周交易锚点。	GPU、ASIC、交换芯片、光互连和HBM共同定义AI工厂成本结构。	S15/S16/S17
2026-06-21至06-27	欧洲 / 设备合规	ASML/EUV相关争议虽未形成官方监管结论，但ASML出口管制合规和先进光刻维护服务仍是敏感议题。	欧洲设备链不仅卖设备，也承担持续服务、软件、零部件和合规责任。	S20/S21
2026-06-21至06-27	东南亚 / 后道承接	SEMI与区域投资口径继续显示东南亚在封测、后道制造和供应链分散中的作用上升。	马来西亚、新加坡、越南、泰国等地不只是低成本基地，也在承接先进封装、测试和全球客户合规需求。	S22/S23

三、区域与产业链观察

区域	主线	本周信号	关注度
美国	CHIPS补贴、AI ASIC、HBM采购、先进封装、SiC功率器件	i-Pulse奖励把政策焦点推向SiC；Micron财报验证存储上行；BIS继续塑造AI算力采购边界。	高
中国大陆	国产设备、特色工艺、存储、AI芯片、封测	武汉新芯股权重划、设备与封测股票强势、出口管制倒逼国产替代与供应链审计。	高

区域	主线	本周信号	关注度
中国台湾	TSMC先进制程、先进封装、设计生态	TSMC技术论坛强化3nm/2nm/A16/A14与3DFabric平台；台股龙头本周回调但产业地位不变。	高
韩国	HBM、DRAM、NAND、AI内存协同	SK hynix与Samsung处于AI内存核心位置，本周股价回调不改变HBM利润池上行逻辑。	高
日本	设备、材料、测试、汽车半导体	Tokyo Electron、Advantest、Renesas等代表设备/测试/汽车链条，受全球capex节奏与汇率扰动影响。	中高
欧洲	EUV、功率半导体、车规与工业链	ASML合规敏感度高，Infineon/STMicro受汽车、工业和功率器件周期影响。	中高
东南亚	封测、OSAT、后道制造、合规分散	供应链区域化让东南亚承接更多封测、先进封装和客户近岸化需求。	中

四、产业链穿透框架

链条	本周信号	产业链传导	后续验证点
AI算力芯片/ASIC	NVIDIA与Broadcom仍是AI芯片和网络芯片交易锚点，AMD通过内存优化补强系统能力。	ASIC、网络、HBM、封装、光互连和电源共同决定AI工厂TCO。	客户订单、云厂商capex、AI ASIC认证、交付周期。
晶圆制造/先进制程	TSMC技术论坛与Intel 18A-P进展共同说明2nm/A16/18A之后竞争进入功耗、互连和生态阶段。	先进节点不只是晶体管密度，还包括backside power、EDA/IP、封装和客户迁移成本。	tape-out数量、良率、客户导入、量产时间表。
存储/HBM/企业SSD	Micron财报与TrendForce价格口径确认存储景气上行。	HBM、大容量DRAM和企业SSD吸收产能，成熟存储价格向汽车/工业传导。	合约价、库存天数、HBM认证、capex、客户长约。
先进封装/封测	CoWoS/SolC/FOPLP、Amkor-TSMC合作和封测股表现说明后道成为前台瓶颈。	封装、测试、载板、混合键合和热管理决定AI芯片可交付性。	CoWoS产能、良率、载板交期、OSAT资本开支。
光互连/网络	AI工厂规模扩大推升800G/1.6T、InP、硅光和CPO重要性。	数据搬运能耗决定算力集群效率，网络芯片和光器件成为隐性利润池。	云厂商采购、InP产能、功耗/bit、交换芯片订单。
设备/材料/零部件	SiC、先进封装、GAA、3D NAND和量测检测共同提升设备复杂度。	设备公司从单机供应商走向工艺、数据和良率协同伙伴。	国产替代订单、关键零部件、维护服务、出口许可。
EDA/IP/RISC-V	AI ASIC、Chiplet和先进封装推高设计验证复杂度。	Synopsys、Cadence、Arm等价值来自验证、IP复用和系统级设计自动化。	授权增长、AI辅助EDA落地、Chiplet接口标准。
汽车/功率/传感	SiC补贴、车规MCU库存和成熟存储价格共同影响汽车电子BOM。	功率器件、MCU、传感和模拟芯片是AI之外的韧性链条。	车企库存、SiC/GaN订单、车规认证、交期。

五、瓶颈、利润池与验证指标

瓶颈	形成原因	潜在利润池	验证指标
HBM与大容量DRAM	AI训练/推理优先吸收先进存储产能，Micron财报强化存储利润池判断。	SK hynix、Samsung、Micron、HBM封装、测试、材料。	HBM认证、ASP、毛利率、capex、客户集中度。
先进封装与封测	CoWoS/SolC/FOPLP决定AI芯片是否能从晶圆变成可交付系统。	TSMC、Amkor、ASE、JCET、通富、华天、封装设备、载板。	新增产能、良率爬坡、载板交期、高端封装收入占比。
SiC功率半导体	新能源车、电网、工业电源和数据中心电源效率共同推高SiC战略价值。	SiC衬底、外延、器件、模块、设备、车规客户。	补贴落地、良率、车规认证、8英寸产线进度。
光互连与AI网络	AI工厂从服务器扩展到rack/cluster，数据搬运能耗成为约束。	Coherent、Broadcom、NVIDIA网络、光模块、硅光/InP。	800G/1.6T订单、功耗/bit、InP产能、云客户认证。
出口管制与合规	管制口径从目的地扩展到总部/最终母公司、物项分类和最终用途。	合规服务、替代芯片、区域供应链、法务审计与ERP管控。	许可证、客户条款、采购替代、监管更新。

六、政策、出口管制、补贴与供应链安全

BIS先进计算物项口径提示，合规风险正在从目的地扩展到总部或最终母公司、控制权、物项分类、最终用途和境外数据中心运营主体。

美国CHIPS资金投向i-Pulse SiC R&D，说明补贴逻辑从先进逻辑继续扩展到功率半导体、汽车电动化、工业电源、数据中心供电和能源基础设施。

ASML/EUV相关报道仍未形成公开监管结论，应列入待跟踪信号；但先进光刻设备、组件、维护服务和软件升级的合规敏感度会继续抬升。

七、技术与产品趋势

先进制程：TSMC技术论坛把3nm、2nm、A16、A14与3DFabric同时呈现，说明先进节点竞争进入功耗、互连、封装和生态协同阶段。

存储/HBM：Micron财报和TrendForce口径共同指向存储利润池上行，HBM、高容量DRAM、企业SSD和成熟存储分别通过AI服务器、云资本开支、汽车和工业控制传导。

先进封装：CoWoS、SoIC、FOPLP、混合键合和载板供给继续是AI芯片交付瓶颈。

功率半导体：SiC和GaN受新能源车、工业电源、数据中心电力转换和电网升级拉动，本周SiC补贴强化了功率器件战略属性。

EDA/IP与AI设计自动化：AI ASIC、Chiplet和3D封装把验证复杂度推高，EDA企业价值来自系统级验证、IP复用、AI辅助设计和跨封装协同。

八、半导体装备制造链专题

环节	本周观察	代表企业/方向
光刻	EUV/High-NA EUV仍决定先进逻辑和部分先进DRAM路线的上限，维护服务和零部件合规同样敏感。	ASML、ZEISS、imec生态；中国客户关注替代曝光与成熟节点优化。
刻蚀/薄膜沉积	GAA、3D NAND、SiC和先进封装提升高深宽比刻蚀、ALD/CVD和材料工程复杂度。	Applied Materials、Lam、TEL、中微公司、北方华创。
检测量测	先进封装和Chiplet把缺陷检测从前道延伸到后道；AI in fab提升过程控制价值。	KLA、Onto、Nova、国内检测量测厂商。
离子注入/清洗/CMP	功率器件、特色工艺、成熟制程和3D结构支撑专用设备需求。	Axcelis、SCREEN、Ebara、TEL、国产平台型设备厂。
封装设备	CoWoS、SoIC、FOPLP、混合键合和玻璃基板推动后道设备成为核心瓶颈。	Besi、ASMPT、K&S、国内封装设备和OSAT生态。
核心零部件	真空泵、阀门、陶瓷件、静电卡盘、射频电源、光学件决定设备国产化上限。	国产替代从整机转向零部件、材料和工艺包协同。

装备链的核心变化是：客户不再只购买单机指标，而是购买工艺窗口、良率爬坡、过程控制、数据闭环和全球服务能力。

九、重点企业动态

- NVIDIA、TSMC、ASML、Samsung、SK hynix、Micron继续构成AI算力、先进制程、EUV和HBM主轴。
- Intel、AMD、Broadcom、Qualcomm分别代表先进制程追赶、系统软件补强、AI ASIC/网络和边缘/汽车AI。
- Applied Materials、Lam、KLA、Tokyo Electron受先进制程、3D NAND、SiC、先进封装和检测量测需求支撑。
- Synopsys、Cadence、Arm受AI ASIC、Chiplet、RISC-V和系统级验证复杂度提升拉动。
- SMIC、华虹、中微、北方华创、长江存储、武汉新芯、长电、通富、华天、兆易、寒武纪、海光体现中国半导体从制造、设备、存储、封测到算力的组合主线。

十、投资、并购、融资、产能建设与合作

区域/类型	事项	规模/动作	产业含义与验证点	来源
美国 / R&D补贴	i-Pulse SiC功率半导体制造技术	CHIPS Program 2.5亿美元R&D奖励。	功率半导体被纳入国家级供应链安全；验证点是研发里程碑、产业化路径和客户导入。	S2
美国 / 存储经营	Micron 2026财年Q3业绩	AI内存需求驱动收入、利润和现金流上行。	HBM、DRAM、企业SSD与capex节奏将影响未来几个季度利润弹性。	S1
美国 / 系统软件	AMD收购MEXT	补强内存优化与分层内存能力。	AI基础设施降本不只靠更快GPU，也靠内存管理和调度软件。	S14
美国 / 先进封装	TSMC-Amkor十年合作	美国本土先进封装与测试链条延伸。	看设备采购、量产节点、客户导入和良率爬坡。	S13
中国 / 存储资本	长江存储拟出让武汉新芯39%股权	地方国资控制权上升，业务边界更清晰。	看后续上市、融资、特色存储/代工定位和产能投入。	S19
东南亚 / 供应链承接	封测与后道制造扩张	区域投资和SEMI口径支持供应链分散趋势。	看先进封装能力、人才供给、客户认证和政策稳定性。	S22/S23

十一、资本市场表现快照

口径：Yahoo Finance复权收盘价，区间为2026-06-22至各市场2026-06-25/26最近可得收盘日；^SOX、NVDA本次接口断连未纳入。仅作产业观察，不构成投资建议。

标的	代码	区间	期初	期末	涨跌幅	币种
SMH ETF	SMH	2026-06-22→2026-06-25	668.91	636.88	-4.79%	USD
TSMC ADR	TSM	2026-06-22→2026-06-25	467.67	434.99	-6.99%	USD
ASML ADR	ASML	2026-06-22→2026-06-25	1,929.25	1,841.18	-4.56%	USD
Broadcom	AVGO	2026-06-22→2026-06-25	392.13	378.91	-3.37%	USD
AMD	AMD	2026-06-22→2026-06-25	551.63	532.57	-3.46%	USD
Micron	MU	2026-06-22→2026-06-25	1,211.38	1,213.56	+0.18%	USD
Qualcomm	QCOM	2026-06-22→2026-06-25	221.90	204.90	-7.66%	USD
Applied Materials	AMAT	2026-06-22→2026-06-25	640.18	668.00	+4.35%	USD
Lam Research	LRCX	2026-06-22→2026-06-25	409.54	401.82	-1.89%	USD
KLA	KLAC	2026-06-22→2026-06-25	269.16	258.80	-3.85%	USD
Intel	INTC	2026-06-22→2026-06-25	140.94	132.87	-5.73%	USD
Synopsys	SNPS	2026-06-22→2026-06-25	464.58	455.02	-2.06%	USD
Cadence	CDNS	2026-06-22→2026-06-25	389.04	368.23	-5.35%	USD
Arm	ARM	2026-06-22→2026-06-25	407.72	347.71	-14.72%	USD
TSMC Taiwan	2330.TW	2026-06-22→2026-06-26	2,510.00	2,340.00	-6.77%	TWD
MediaTek	2454.TW	2026-06-22→2026-06-26	4,465.00	3,880.00	-13.10%	TWD
ASE Tech Taiwan	3711.TW	2026-06-22→2026-06-26	674.00	632.00	-6.23%	TWD
SK hynix	000660.KS	2026-06-22→2026-06-26	2,919,000.00	2,673,000.00	-8.43%	KRW
Samsung Electronics	005930.KS	2026-06-22→2026-06-26	353,500.00	339,500.00	-3.96%	KRW
Tokyo Electron	8035.T	2026-06-22→2026-06-26	77,800.00	72,920.00	-6.27%	JPY
Advantest	6857.T	2026-06-22→2026-06-26	32,170.00	32,440.00	+0.84%	JPY
Renesas	6723.T	2026-06-22→2026-06-26	5,041.00	4,800.00	-4.78%	JPY
SMIC A	688981.SS	2026-06-22→2026-06-26	145.59	148.76	+2.18%	CNY
SMIC H	0981.HK	2026-06-22→2026-06-26	78.90	80.00	+1.39%	HKD
Hua Hong	1347.HK	2026-06-22→2026-06-26	164.60	189.50	+15.13%	HKD
NAURA	002371.SZ	2026-06-22→2026-06-26	745.00	813.37	+9.18%	CNY
AMEC	688012.SS	2026-06-22→2026-06-26	372.74	413.00	+10.80%	CNY

标的	代码	区间	期初	期末	涨跌幅	币种
Cambricon	688256.SS	2026-06-22→2026-06-26	1,456.99	1,458.00	+0.07%	CNY
Hygon	688041.SS	2026-06-22→2026-06-26	327.15	344.90	+5.43%	CNY
JCET	600584.SS	2026-06-22→2026-06-26	91.23	100.89	+10.59%	CNY
Tongfu Micro	002156.SZ	2026-06-22→2026-06-26	71.25	71.60	+0.49%	CNY
HT-Tech	002185.SZ	2026-06-22→2026-06-26	20.44	22.56	+10.37%	CNY
GigaDevice	603986.SS	2026-06-22→2026-06-26	689.70	770.00	+11.64%	CNY
WillSemi	603501.SS	2026-06-22→2026-06-26	90.56	86.72	-4.24%	CNY
Infineon	IFX.DE	2026-06-22→2026-06-26	85.94	78.30	-8.89%	EUR

市场解读：本周AI芯片高位波动与中国半导体链修复并存。中国设备、封测、存储和特色工艺标的表现较强，海外龙头多有回调。

十二、供需、价格、库存、产能与风险信号

主题	本周信号	产业影响	验证指标
存储价格	DRAM/HBM/企业SSD及NOR/SLC NAND价格偏强。	服务器优先级挤压PC、手机、汽车和工业链条。	合约价、库存、长约比例、供应商capex。
先进封装产能	CoWoS/SolC/FOPLP与HBM堆叠仍是AI芯片交付瓶颈。	晶圆产出不等于系统可交付，后道排产决定收入确认。	排产、良率、载板交期、OSAT订单。
SiC供给	补贴与产业投资会加速SiC制造技术迭代。	产能扩张若快于车规/工业需求，可能带来价格压力。	8英寸良率、车规认证、模块订单。
出口管制	先进计算物项按实体归属和最终用途审查。	跨境AI基础设施采购、云服务和系统集成复杂度上升。	许可证、客户合规条款、替代供应。
人才与组织	封装、EDA验证、AI in fab、设备维护和全球合规人才短缺。	人才瓶颈会直接拖慢良率、爬坡和质量体系建设。	招聘周期、关键岗位流失率、产线KPI。

十三、管理观察与行动建议

- 把AI基础设施拆成“计算、存储、封装、互连、电源、散热、测试、合规”八类瓶颈来管理，而不是只盯GPU采购。
- 半导体企业的数字化重点应从财务/销售报表转向研发项目组合、工艺知识库、良率归因、设备维护、供应商风险和客户认证闭环。
- 对制造型企业，存储、功率器件和车规芯片的采购策略要从季度议价升级为关键料战略库存、双源认证和BOM弹性设计。
- 对出海企业，出口管制合规需要进入ERP、客户主数据、合同审批和供应链审计流程，不能只依赖法务事后判断。

对象	建议
企业家	建立半导体关键料战略地图，重点跟踪存储、功率器件、先进封装、光互连、MCU和传感器的交期、价格与替代方案。
投资者	区分价格周期弹性与结构性能力提升，重点验证存储、设备、封测、SiC和EDA/IP企业的订单质量、毛利率和现金流。
产业链研究专家	用“瓶颈-利润池-验证指标”框架替代新闻堆叠，围绕HBM、CoWoS/SolC、SiC、InP/硅光、检测量测、出口管制建数据表。
管理咨询专家	围绕研发管理、供应链韧性、质量体系、AI in fab、全球合规和组织能力，为半导体客户设计端到端变革项目。

十四、半导体知识点

SiC功率半导体

一句话定义：以碳化硅为材料体系的功率器件，适合高电压、高温、高效率场景。

为什么本周重要：CHIPS Program本周把2.5亿美元R&D奖励投向SiC制造技术，说明功率器件已经进入美国供应链安全视野。

企业/投资/管理含义：企业关注电源效率和车规认证；投资者要看8英寸良率、客户认证和价格曲线；咨询顾问可切入质量体系、良率爬坡和供应链协同。

3DFabric

一句话定义：TSMC对先进封装和3D芯片堆叠平台的总称，覆盖CoWoS、InFO、SoIC等技术组合。

为什么本周重要：TSMC中国技术论坛继续把先进制程和3DFabric一起呈现，说明客户买的不是单一晶圆，而是系统级制造能力。

企业/投资/管理含义：企业采购AI芯片要问封装排产和热管理；投资研究要看OSAT、载板、测试、设备和材料；管理上要打通设计、制造、封装、测试和客户认证。

十五、下周待跟踪信号

- Micron下一季度指引、HBM收入占比和capex节奏是否继续支持存储上行。
- TSMC技术论坛后续是否披露更多2nm/A16/A14客户导入和3DFabric扩产信息。
- BIS先进计算物项FAQ是否引发云服务、境外数据中心和AI系统集成合同调整。
- SiC补贴项目是否形成可量产的8英寸工艺、良率和车规客户导入。
- ASML/EUV相关争议是否出现荷兰政府、美国商务部或ASML进一步公开口径。
- A/H股设备、封测、存储链强势能否被订单、毛利和现金流验证，而非仅停留在主题交易。
- 东南亚封测和后道制造扩张是否带来先进封装人才、质量体系和客户认证瓶颈。

十六、来源附录与链接

[S1] Micron：2026财年第三季度业绩公告

<https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-technology-inc-reports-results-third-quarter>

[S2] NIST / CHIPS Program：i-Pulse 2.5亿美元SiC R&D奖励

<https://www.nist.gov/news-events/news/2026/06/departments-commerce-announces-definitive-agreement-i-pulse-250-million>

[S3] TSMC：2026 Technology Symposium官方页面

<https://www.tsmc.com/static/english/campaign/Symposium2026/index.htm>

[S4] SIA：2026年4月全球半导体销售与WSTS春季预测

<https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-11-month-to-month-in-april/>

[S5] BIS：先进计算物项对D:5与澳门总部实体许可要求说明

<https://www.bis.gov/media/documents/bis-guidance-may-31-2026.pdf>

[S6] BIS：先进计算物项D:5与澳门总部实体FAQ

<https://www.bis.gov/media/documents/fdd-faqs-06.17.26.pdf>

[S7] TSMC：2026年5月营收报告

<https://pr.tsmc.com/english/news/3320>

[S8] Intel Foundry：VLSI 2026工艺节点与18A-P进展

<https://newsroom.intel.com/intel-foundry/intel-foundry-details-process-milestones-future-innovation-at-vlsi-symposium>

[S9] VLSI Symposium：2026技术亮点

<https://www.vlssymposium.org/wp-content/uploads/2026/04/2026-VLSI-Technical-Tipsheet-REVISED-FINAL-4.25.26-1-1.pdf>

[S10] TrendForce：NOR Flash与SLC NAND价格和短缺

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260616-13102.html>

[S11] TrendForce：1Q26 DRAM行业收入与合约价格

<https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260601-13070.html>

[S12] TrendForce：TSMC CoWoS供需缺口与扩产观察

<https://www.trendforce.com/news/2026/06/15/news-tsmc-cowos-supply-demand-gap-reportedly-seen-narrowing-from-20-to-10-by-end-2026-as-capacity-expands/>

[S13] TSMC / Amkor : 十年亚利桑那先进封装合作
<https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/tsmc-and-amkor-technology-announce-long-term-partnership>

[S14] AMD : 收购MEXT推进内存优化
<https://www.amd.com/en/blogs/2026/amd-acquires-mext-for-memory-optimization.html>

[S15] NVIDIA : Vera Rubin与AI工厂供应链协同
<https://nvidianews.nvidia.com/news/vera-rubin-full-production-agentic-ai-factory>

[S16] NVIDIA : 2027财年一季度财报
<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-Financial-Results-for-First-Quarter-Fiscal-2027/default.aspx>

[S17] Broadcom : 2026财年二季度财报
<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-inc-announces-second-quarter-fiscal-year-2026-financial>

[S18] NVIDIA / SK hynix : 多年AI内存与AI工厂技术合作
<https://nvidianews.nvidia.com/news/sk-hynix-ai-factory>

[S19] 证券时报 : 长江存储拟出让武汉新芯39%股权
<https://www.stcn.com/article/detail/3969332.html>

[S20] ASML : 出口管制合规声明
<https://www.asml.com/news/press-releases/2023/statement-regarding-export-control-regulations-dutch-government>

[S21] Reuters / MarketScreener : ASML否认EUV相关发运报道
<https://www.marketscreener.com/news/us-tells-asml-it-s-concerned-one-of-its-chipmaking-tools-may-be-in-china-bloomberg-news-reports-ce7f5cd2db8af121>

[S22] SEMI : Southeast Asia Semiconductor Pulse
<https://www.semi.org/sea/blogs/February-2026>

[S23] MIDA : 2026年马来西亚投资公告口径
<https://www.mida.gov.my/announcement-year/2026/>

[S24] Yahoo Finance : 2026-06-22至2026-06-26复权收盘价抓取
<https://finance.yahoo.com/>

[S25] SEC EDGAR : 上市公司财务公告与8-K检索入口
<https://www.sec.gov/edgar/search/>